

- ・ 新規なダイヤモンド接合技術を開発し 半導体層間膜平坦化で多用されるCMPプロセスで使用されるCMPコンディショナに革新的機能と低価格を付与する。

研究開発の成果

■ **ダイヤモンド位置精度の向上**

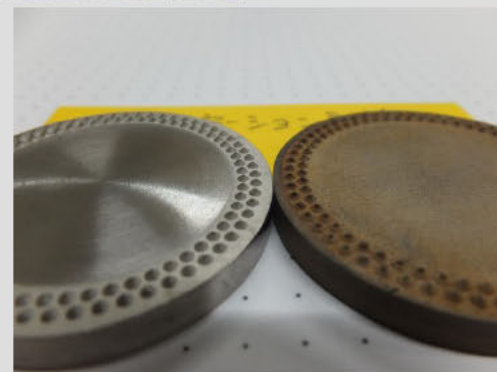
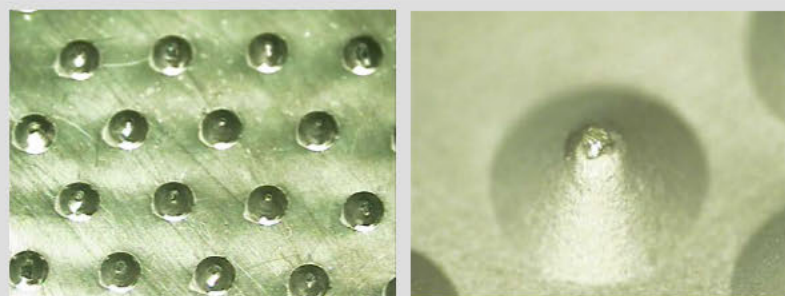
ダイヤモンドのピッチ・高さを任意にコントロールして
コンディショニング条件に合わせたコンディショナを提供する。

■ **ダイヤモンドの接合強度の安定化**

ダイヤモンド接合強度を安定化してダイヤモンドの脱落を防止する。

■ **低価格化**

ステンレス台金を使用しないでCMPコンディショナを製作して
低価格化を実現した。



研究体制

事業管理機関 (株)アイゼン

(株)アイゼン 大阪大学 接合科学研究所 神戸大学 海事
科学研究科 大阪産業技術研究所 (株)荏原製作所
鹿児島工業技術センター

当該研究開発の連絡窓口

(株)アイゼン 山下保喜

E-mail : yamashita-y@eisen.gr.jp

電話番号 : 0748-45-5100